

各位

お問い合わせ先

テリー・エマーソン (Terry Emerson)

terry.emerson@samtec.com

812-981-8304

[SAMTEC LOGO]

Samtec 社、高速かつ正確なアラインメントを実現する カードエッジコネクタ新製品を発表

ハイスピード Edge Rate® コンタクトをもつ 0.80 mm および
1.00 mm ピッチのカードエッジソケット

インディアナ州ニューアルバニー：Samtec 社は、カードエッジコネクタのラインナップを拡充し、より高速なアプリケーションと最良の嵌合アラインメントを実現する 0.80 mm および 1.00 mm ピッチのソケットを発表しました。

0.80 mm ピッチのソケット ([HSEC8-DP シリーズ](#)) は、好評を博している Samtec 社の Edge Rate® 0.80 mm ピッチのソケットの差動対ペアバージョンです。

28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4 の速度まで対応し、本ソケットは、サイクル寿命を延ばし、クロストークを抑制する Edge Rate® コンタクトを採用しています。2 列ソケットは、8~56 対ペアまで対応、オプションで堅牢な溶接タブの選択も可能で、標準の厚さ 1.60 mm のカードと嵌合します。

最速 28 Gbps に最適化された、1.00 mm ピッチのカードエッジソケット ([HSEC1 シリーズ](#)) も、シグナルインテグリティを最適化する Edge Rate® コンタクトを採用し、オプションで位置合わせピンと堅牢な溶接タブの選択も可能です。本ソケットは、最大 140 極まで対応、標準の厚さ 1.60 mm のカードと嵌合します。特別なアプリケーションに関しては、本カードエッジソケットは、X 軸・Y 軸におけるずれを防止し、コンタクトとパッドのコネクションを最適化します。

[Edge Rate® コンタクト](#)の、スムーズで、幅の広い、フライス加工された嵌合面は、ブロードサイド結合の影響を最小化することで、クロストークを抑制、優れたシグナルインテグリティ性能を実現します。材料断面がまっすぐで、より一定であることで、インピーダンスコントロールが向上しています。抜き差し時の堅牢性が高いこのコンタクトシステムは、有効嵌合長最大 1.5 mm を実現、嵌合角度の公差を拡大しています。また、Edge Rate® コンタクトは、様々なハイスピードプロトコルおよび基準に対応しています。

Samtec 社のマイクロラジドプロジェクトマネージャのテリー・エマーソン (Terry Emerson) は、次のように述べています。「当社の Edge Rate® ブランドは、高速信号を利用可能にしながら、機械的完全性を最高に保てる、汎用性のあるソリューションとして業界で知られています。これら 2 つの新製品は、Edge Rate® ブランドの更なる成長を継続するものです。」

Samtec 社の [ハイスピードカードエッジコネクタ](#) のフルラインは、様々なピッチや取り付け方向に対応しています。一般的な 0.80 mm ピッチの Edge Rate® ソケット ([HSEC8 シリーズ](#)) は、垂直、貫通、ライトアングル、またはエッジマウント方向、スタック高さ 30 mm まで対応します。0.50 mm マイクロピッチソケット ([MEC5 シリーズ](#)) は、位置揃えビームが付いているので標準の PCB 公差の使用が可能であるとともに、PCIe® Gen 4 に準拠しています。

標準のハイスピードカードエッジソケットは、以下のシリーズで構成されています：0.635 mm ([MEC6 シリーズ](#))、0.80 mm ([MEC8 シリーズ](#))、1.00 mm ([MEC1 シリーズ](#))、1.27 mm ([MECF シリーズ](#))、および 2.00 mm ([MEC2 シリーズ](#))。1.00 mm ピッチ PCI Express® ソケット ([PCIE シリーズ](#)) は x1/x4/x8/x16 に対応しており、低背タイプ ([PCIE-LP シリーズ](#)) は Gen 4 速度に準拠しています。1.00 mm ピッチのマイクロプレーンソケット ([SAL1 シリーズ](#)) は、SATALink™ に準拠しており、様々な嵌合カード厚さに対応できるよう 2 つ 1 組で搭載します。

Samtec 社のシグナルインテグリティグループ ([Signal Integrity Group](#)) は、これらカードエッジコネクタおよびその他多数の製品について、社内のシグナルインテグリティ技術者を介してアプリケーション支援を行います。当社の優れた技術者が、フルチャネル分析、高データレートシミュレーション、アプリケーション別設計・開発援助、および高度設計支援のお手伝いをいたします。

詳細は、Samtec 社の [カードエッジコネクタシステム](#) のウェブページをご覧ください。

PCI-SIG®、PCI Express® および PCIe® ロゴマークは、PCI-SIG の登録商標および/またはサービスマークです。

Samtec, Inc.について

1976 年創業の Samtec 社は、非上場企業で、年間売上高は 6 億 6,200 万ドルに上ります。IC とボード間および IC パッケージ、高速ボード・ツー・ボード、高速ケーブル、ミッドボードおよびパネル・オプティクス、フレキシブル・スタッキング、ならびに小型/堅牢部品およびケーブル等、幅広い電子インターコネクタソリューションの製品を有する、世界的な製造業者です。Samtec テクノロジ

ー・センターは、ベアダイから距離 100 メートルのインターフェースまでのシステムおよびその間のあらゆるインターコネクトポイントに関して、性能・コスト共に最適化するための、技術、戦略および製品の開発・高度化に注力しています。18 カ国、33 箇所の拠点における、Samtec 社の世界的なサポート体制が比類なき顧客サービスの提供を可能としています。より詳しい情報は、Samtec 社ウェブサイトをご覧ください (<http://www.samtec.com>)。

Samtec, Inc.
P.O. Box 1147
New Albany, IN 47151-1147
USA
電話: 1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)
www.samtec.com